華南期貨
HUA NAN FUTURES

SEMICON Taiwan 2026
AI 驅動的產業新紀元

2026.09.01 華南期貨顧問事業部編製

華南期貨 HUA NAN FUTURES
本報告僅供華南金控集團內部同仁及特定客戶參考，純屬研究性質，不得視為投資依據亦不代表未來獲利之預期或保證。本報告內容來自製作時，各項公開與據信可靠資訊來源，有其時效性，日後如有任何變動，本公司將不作預告或更新。投資人應審慎衡量自身投資風險，並就投資結果自行負責，本公司不負任何法律責任。本報告內容之著作權屬於本公司所擁有，非經本公司同意，不得以任何方式抄襲、引用或轉寄。華南金融集團 華南期貨股份有限公司　台北總公司 : (112)金管期總字第007號 台北市松山區民生東路四段 54 號 3 樓之 9。 TEL : 02-27180000 FAX : 02-25463700

展會規模創新高

華南期貨 HUA NAN FUTURES

1,300+
參展企業

4,300+
展覽攤位

18
國家館

2026年9月2日至4日在台北南港展覽館一、二館

展會重心已正式發生轉折—半導體供應鏈的終極目標已全面延伸至 AI 巨型資料中心的系統建置。

今年新加入的國家如西班牙、墨西哥、芬蘭等等

顯示AI革命正快速席捲全球，企業間展開更廣闊與更深入的合作

華南期貨 HUA NAN FUTURES
本報告僅供華南金控集團內部同仁及特定客戶參考，純屬研究性質，不得視為投資依據亦不代表未來獲利之預期或保證。本報告內容來自製作時，各項公開與據信可靠資訊來源，有其時效性，日後如有任何變動，本公司將不作預告或更新。投資人應審慎衡量自身投資風險，並就投資結果自行負責，本公司不負任何法律責任。本報告內容之著作權屬於本公司所擁有，非經本公司同意，不得以任何方式抄襲、引用或轉寄。華南金融集團 華南期貨股份有限公司　台北總公司 : (112)金管期總字第007號 台北市松山區民生東路四段 54 號 3 樓之 9。 TEL : 02-27180000 FAX : 02-25463700

CSP業者主導的規格革命

Google、微軟、NVIDIA 深度參與，競爭從「製造執行」升級為「跨層級系統整合」



價值轉移：

不再只是接單代工，而是跟隨雲端巨頭系統需求迭代的能力，決定了供應鏈的未來板塊。

本報告僅供華南金控集團內部同仁及特定客戶參考，純屬研究性質，不得視為投資依據亦不代表未來獲利之預期或保證。本報告內容來自製作時，各項公開與據信可靠資訊來源，有其時效性，日後如有任何變動，本公司將不作預告或更新。投資人應審慎衡量自身投資風險，並就投資結果自行負責，本公司不負任何法律責任。本報告內容之著作權屬於本公司所擁有，非經本公司同意，不得以任何方式抄襲、引用或轉寄。華南金融集團 華南期貨股份有限公司　台北總公司 : (112)金管期總字第007號 台北市松山區民生東路四段 54 號 3 樓之 9。 TEL : 02-27180000　FAX : 02-25463700

先進封裝根本性突破

從晶圓級（CoWoS）到面板級（FOPLP & 玻璃基板），追求晶圓利用率與成本平衡

晶圓級封裝 (CoWoS)

- 現行主流：產能極度吃緊，高階 AI 封裝絕對主流
- 物理極限：面臨矽中介層光罩尺寸限制

面板級封裝 (FOPLP & 玻璃基板)

- 次世代解法：

  突破光罩極限，面積利用率提升，單位成本下降

- 跨界生態：

  群創(3481)、友達(2409)、日月光(3711) 挾黃光製程優勢跨界入局

小晶片 (Chiplet) 異質整合、台積電預計2028年以玻璃基板為基礎的 CoPoS 進入量產

本報告僅供華南金控集團內部同仁及特定客戶參考，純屬研究性質，不得視為投資依據亦不代表未來獲利之預期或保證。本報告內容來自製作時，各項公開與據信可靠資訊來源，有其時效性，日後如有任何變動，本公司將不作預告或更新。投資人應審慎衡量自身投資風險，並就投資結果自行負責，本公司不負任何法律責任。本報告內容之著作權屬於本公司所擁有，非經本公司同意，不得以任何方式抄襲、引用或轉寄。華南金融集團 華南期貨股份有限公司　台北總公司 : (112)金管期總字第007號 台北市松山區民生東路四段 54 號 3 樓之 9。 TEL : 02-27180000　FAX : 02-25463700

光進銅退

AI 算力擴張引爆頻寬與功耗危機，矽光子 (SiPh) 與 共同光學封裝(CPO) 正式步入商業化量產

傳統銅導線 (電傳輸)
面臨頻寬與散熱物理極限
高功耗成為 AI 算力擴張最大阻礙

矽光子與 CPO
電子訊號轉換為光子傳輸
實現無損耗、極低功耗次世代互連

1. 晶圓代工
台積電 COUPE 平台投入生產
聯電首批量產晶圓交付

2. 交換機系統
鴻海 CPO 交換機
Q3 逐步交貨

3. 封裝與檢測
訊芯-KY、力成佈局封裝
閎康、穎崴建置專屬測試設備

本報告僅供華南金控集團內部同仁及特定客戶參考，純屬研究性質，不得視為投資依據亦不代表未來獲利之預期或保證。本報告內容來自製作時，各項公開與據信可靠資訊來源，有其時效性，日後如有任何變動，本公司將不作預告或更新。投資人應審慎衡量自身投資風險，並就投資結果自行負責，本公司不負任何法律責任。本報告內容之著作權屬於本公司所擁有，非經本公司同意，不得以任何方式抄襲、引用或轉寄。華南金融集團 華南期貨股份有限公司　台北總公司 : (112)金管期總字第007號 台北市松山區民生東路四段 54 號 3 樓之 9。 TEL : 02-27180000 FAX : 02-25463700

台灣於AI 時代的不可替代性

從黃仁勳到 Google Amin Vahdat 的共識：台灣是 AI 革命的運算引擎

「台灣處於 AI 基礎設施的中心。」
- 黃仁勳 (NVIDIA)

「系統級創新，高度依賴台灣緊密的供應鏈協作。」
- Amin Vahdat (Google)

Taiwan Plus One
具韌性的非紅供應鏈

快速彈性
高階人才與核心製程留台

西方信任
長期的合規與信賴

最先進的封裝 + 光電整合 + 絕對信任 = 台灣

本報告僅供華南金控集團內部同仁及特定客戶參考，純屬研究性質，不得視為投資依據亦不代表未來獲利之預期或保證。本報告內容來自製作時，各項公開與據信可靠資訊來源，有其時效性，日後如有任何變動，本公司將不作預告或更新。投資人應審慎衡量自身投資風險，並就投資結果自行負責，本公司不負任何法律責任。本報告內容之著作權屬於本公司所擁有，非經本公司同意，不得以任何方式抄襲、引用或轉寄。華南金融集團 華南期貨股份有限公司　台北總公司 : (112)金管期總字第007號 台北市松山區民生東路四段 54 號 3 樓之 9。 TEL : 02-27180000 FAX : 02-25463700

可關注標的

發展領域	可關注企業 (紅字表示有股期)
IC設計	聯發科(2454)、聯詠(3034)、鈺創(5351)、世芯-KY(3661)
記憶體	南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)、威剛(3260)、創見(2451)
晶圓製造	台積電(2330)、聯電(2303)、力積電(6770)
半導體載板(ABF)	欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)
封裝測試	日月光投控(3711)、京元電(2449)、力成(6239)、南茂(8150)
電子製造	鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)
矽光子與光通訊	聯亞(3081)、上詮(3363)、波若威(3163)、華星光(4979)、智邦(2345)
量子運算	鴻海(2317)、廣達(2382)、仁寶(2324)、致茂(2360)

華南期貨 HUA NAN FUTURES
本報告僅供華南金控集團內部同仁及特定客戶參考，純屬研究性質，不得視為投資依據亦不代表未來獲利之預期或保證。本報告內容來自製作時，各項公開與據信可靠資訊來源，有其時效性，日後如有任何變動，本公司將不作預告或更新。投資人應審慎衡量自身投資風險，並就投資結果自行負責，本公司不負任何法律責任。本報告內容之著作權屬於本公司所擁有，非經本公司同意，不得以任何方式抄襲、引用或轉寄。華南金融集團 華南期貨股份有限公司　台北總公司 : (112)金管期總字第007號 台北市松山區民生東路四段 54 號 3 樓之 9。 TEL : 02-27180000 FAX : 02-25463700

Thank You Very Much!

華南期貨顧問事業部

免責聲明　本報告僅供華南金控集團內部同仁及特定客戶參考，純屬研究性質，不得視為投資依據亦不代表未來獲利之預期或保證。本報告內容來自製作時，各項公開與據信可靠資訊來源，有其時效性，日後如有任何變動，本公司將不作預告或更新。投資人應審慎衡量自身投資風險，並就投資結果自行負責，本公司不負任何法律責任。本報告內容之著作權屬於本公司所擁有，非經本公司同意，不得以任何方式抄襲、引用或轉寄